

Техническая спецификация | Самоклеящийся материал

WOOD FREE 70 ACR WCCK78 HENGJI

Артикул	HB7078	100824 от 06/08/24					
Сфера применения	Материал подходит для различных методов печати, таких как офсетная, глубокая и флексопечать. Благодаря отличными характеристиками обработки бумаги, он подходит для ротационных и плоских методов обработки. Крафтовая подложка обладает хорошими характеристиками для высечки и может быть использована для печати.						
Лицевой материал	Высококачественная офсетная бумага.						
	Плотность	$80 \pm 5\%$	г/м ²	(GB/T 451.2-2002)			
	Толщина	$78 \pm 5\%$	мкм	(GB/T 451.3-2002)			
	Белизна	≥ 85	%	(GB/T 7974-2002)			
Клей	Акриловый клей, постоянный. FTM 9 методом петли Температура этикетирования Температура эксплуатации	$\geq 14 \pm 10\%$	Н/25 мм				
		от 10°C					
		-10 / +65°C					
Подложка	Крафт подложка, силиконизированная.						
	Плотность	$78 \pm 5\%$	г/м ²	(GB/T 451.2-2002)			
	Толщина	$80 \pm 5\%$	мкм	(GB/T 451.3-2002)			
Ламинат	Плотность	$165 \pm 5\%$	г/м ²	(ISO 536)			
	Толщина	$165 \pm 5\%$	мкм	(ISO 534)			
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $50\% \pm 5\%$. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.						
Дополнительно	Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от $+10^{\circ}\text{C}$ и влажности $50\% \pm 5\%$. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.						